

[首页](#)[政采法规](#)[购买服务](#)[监督检查](#)[信息公告](#)[国际专栏](#)当前位置：[首页](#) » [政采公告](#) » [中央公告](#) » [更正公告](#)

复旦大学有源硅中介层芯片封装加工服务延期公告

2026年09月29日 11:05 来源：中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：FW2026090901

原公告的采购项目名称：复旦大学有源硅中介层芯片封装加工服务公开招标公告

首次公告日期：2026年09月20日

二、更正信息

更正事项：采购公告

更正内容：

招标文件的获取截止时间延期至：2026年10月8日17:00时。

开标和投标截止时间延期至：2026年10月19日09:30时。

其余内容不变。

更正日期：2026年09月29日

三、其他补充事宜

已获取招标文件的供应商须登录复旦大学采购与招标管理系统(网址为:<https://cz.fudan.edu.cn>)下载更新的招标文件，并将招标文件重新导入复旦大学采购与招标管理系统的投标文件编制工具后制作投标文件。未重新下载招标文件并将招标文件导入投标文件编制工具后制作的投标文件将无法在复旦大学采购与招标管理系统中提交，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：复旦大学

地址：中国上海市杨浦区邯郸路220号

联系方式：李老师 86-21-65641327

2.采购代理机构信息

名 称：上海政采项目管理有限公司

地 址：上海市静安区天目中路383号10楼

联系方式：王一澄、孙健峰 021-62091273-8003, 15921879725

3.项目联系方式

项目联系人：王一澄、孙健峰

电 话： 86-21-62091273*8003, 15921879725



主办单位：中华人民共和国财政部国库司

网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号

© 1999-2026 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈